

DATOS GENERALES

Curso académico	Curso 2024/2025
Tipo de curso	Máster de Formación Permanente
Número de créditos	60,00 Créditos ECTS
Matrícula	0 euros (importe precio público pendiente de aprobación por el Consejo Social Universitat de València.)
Requisitos de acceso	<p>Los perfiles de ingreso recomendado se corresponderán a los perfiles formativos de los siguientes planes de estudio a nivel de grado: Ingeniería Electrónica de Telecomunicación, Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería Electrónica Industrial, Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, Ingeniería Electroónica Industrial y Automática, Informática Industrial y Robótica, Ingeniería Informática, o grados, nacionales o extranjeros, con una alta afinidad a los aquí enumerados.</p> <p>También podrían considerarse graduados en: Ingeniería de la Energía, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Telemática, Ingeniería Robótica, Ingeniería Física, o títulos afines.</p> <p>En menor medida, podrían considerarse perfiles científicos tradicionales como Grado en Física, Grado en Matemáticas o Grado en Ciencia de Datos.</p> <p>Se permitirá el acceso al estudiantado que le falte menos de un 10% de los créditos para terminar los estudios de grado, de forma condicionada a que se aprueben durante el mismo curso académico.</p> <p>Respecto al perfil personal del estudiante que mejor se adapta, corresponde a personas que quieran profundizar con rigor en los conocimientos y las habilidades que se requieren para especializarse en las áreas descritas para la orientación profesional. Así deberían tener una afinidad con la microelectrónica como motor en amplios sectores socioeconómicos, y en especial, como contribución esencial en sectores estratégicos industriales.</p>

Modalidad	Presencial
Lugar de impartición	ETSE
Horario	Tardes y sábado

Dirección

Organizador	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV)
Dirección	Abilio Candido Reig Escrivá Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrónica. Universitat de València María Teresa Bacete Castellá Site Director. Maxlinear

Plazos

Preinscripción al curso	Hasta 12/07/2024
Fecha inicio	Septiembre 2024
Fecha fin	Junio 2025

Más información

Teléfono	961 603 000
E-mail	informacion@adeituv.es

PROGRAMA

Dispositivos Electrónicos y fotónicos

- TEORÍA (36 horas)
- Tema 1. Fundamentos de Electrónica y Física de Semiconductores (6 horas).
- 1.1. Teoría de bandas y estructura cristalina.
 - 1.2. Materiales semiconductores: propiedades ópticas y eléctricas.
 - 1.3. La unión PN.
- Tema 2. Dispositivos electrónicos (12 horas).
- 2.1. Diodos.
 - 2.2. Transistor BJT.
 - 2.3. Transistor MOS.
- Tema 3. Dispositivos fotónicos (6 horas).
- 4.1. Fotodetectores.

- 4.2. Diodo LED y Láser.
 - 4.3. Dispositivos Ópticos integrados.
- Tema 4. Tecnología microelectrónica (12 horas).
- 4.1. Crecimiento cristalino y depósito de capas delgadas.
 - 4.2. Recubrimiento de obleas: oxidación, implantación iónica y difusión.
 - 4.3. Litografía Óptica.
 - 4.4. Definición de patrones por ataque químico y plasma.

LABORATORIO (24 horas)

1. Simulación y caracterización del diodo (3 horas).
2. Simulación y caracterización transistor BJT (3 horas).
3. Simulación y caracterización del transistor MOSFET (3 horas).
4. Implementación de un amplificador/conmutador (3 horas).
5. Caracterización dispositivos optoelectrónicos (6 horas).
6. Práctica/demo 1 sala gris (3 horas).
7. Práctica/demo 2 sala gris (3 horas).

Diseño CMOS analógico

TEORIA (30h)

1. Introducción al diseño microelectrónico analógico
2. Diseño CMOS
3. Amplificadores CMOS monoetapa
4. Amplificadores CMOS diferenciales
5. Bloques básicos de diseño y circuitos de acondicionamiento
6. Amplificador operacional

LABORATORIO (30h)

1. Introducción. Caracterización de transistores MOS.
2. Fuentes y espejos de corriente
3. Amplificadores monoetapa
4. Amplificadores diferenciales
5. Amplificador diferencial. Análisis preliminar.
6. Análisis paramétricos
7. Optimización y casos límite ("corners")
8. "Layout". Posicionado e interconexión.
9. Verificación del layout. DRC. LVS.
10. Extracción de parámetros. QRC. Xstream.

Diseño CMOS digital

Los contenidos de la teoría se han distribuido en 8 temas y un total de 3 ECTS.

TEORIA (30h)

Tema 1: El transistor MOS en conmutación.

En este tema se estudian las características eléctricas básicas del transistor trabajando en conmutación. Se estudia la puerta básica inversora y Schmitt-Trigger.

Tema 2: Puertas básicas CMOS y bloques combinacionales.

Puertas NAND, NOR, XOR. Niveles de ruido. Decodificadores, codificadores, multiplexores, comparadores.

Tema 3: Circuitos secuenciales CMOS.

Latch y flip-flop. Registros de desplazamiento, contadores y otros bloques combinacionales. Máquinas de estados.

Tema 4: Temporización.

Estudio de los tiempos que intervienen en el camino de datos y en el reloj.

Tema 5: Planificación de la alimentación.

Dominios de alimentación. Circuitos mixtos analógicos y digitales.

Tema 6: Planificación del Layout.

Áreas en el layout. Diseño de I/O.

Tema 7: Introducción a la síntesis lógica.

Descripción del diseño, esquemas y lenguajes, VHDL y Verilog.

Tema 8: Simulación y bancos de pruebas.

Preparación del circuito para simulación. Diseño y especificación de los bancos de pruebas.

LABORATORIO (30h)

El laboratorio supone un total de 3 ECTS distribuidos en 10 prácticas de 0,3 ECTS cada una.

Práctica 1: Puerta inversora CMOS, análisis estático y dinámico.

En esta sesión se introduce el uso de las herramientas de CAD para el diseño de circuitos digitales CMOS. Se diseña una puerta inversora CMOS y se estudian sus características mediante la simulación eléctrica Spice. Se estudian las características estáticas y dinámicas.

Práctica 2: Bloques combinacionales, análisis del camino de datos.

En esta sesión se diseñan algunas puertas con las que se crean circuitos básicos para estudiar los efectos en las características dinámicas de las cargas, así como los retrasos introducidos por el número de etapas y la carga.

Práctica 3: Bloques secuenciales, simulación de la frecuencia máxima.

En esta sesión se diseña un circuito secuencial simple y se estudia la frecuencia máxima de funcionamiento según diferentes circunstancias.

Práctica 4: Introducción al layout full-custom.

En esta sesión se estudia el funcionamiento de la herramienta de layout mediante la creación de un circuito combinacional básico. Se introducen los chequeos DRC y LVS.

Práctica 5: Diseño mixto analógico/digital.

En esta sesión se diseña y analiza un circuito mixto analógico/digital, prestando especial atención a los dominios de alimentación.

Práctica 6: Extracción de propiedades y simulación post-layout.

En esta sesión se implementa un circuito digital, se extraen sus propiedades a partir del layout y se simula, comparando los resultados pre y post layout.

Práctica 7: Anillo I/O.

En esta sesión se diseña el anillo de entrada/salida del chip con parte analógica y digital y separación de los dominios de alimentación.

Práctica 8: Análisis de los elementos básicos de una biblioteca digital.

En esta sesión se analiza un circuito digital construido a partir de elementos de una biblioteca digital.

Práctica 9: Simulación digital

En esta sesión se crea un circuito a partir de los elementos digitales de una biblioteca y se simula con un simulador digital.

Práctica 10: Introducción a la síntesis lógica.

En esta sesión se diseña un circuito sencillo utilizando un lenguaje de descripción hardware, se sintetiza generando el layout, se comprueba que coinciden layout y descripción y se simula.

Test y verificación

Bloque I Test (15h)

Teoría (6 h)

Introducción

Tipos de errores

Tipos de tests

Hardware

Instrumentación

Análisis de resultados

Prácticas (9h)

1. Latch up en transistores / Caracterización térmica
2. Automatización de medidas
3. Análisis de datos (R/Matlab)

Bloque II Verificación digital (45h)

Introducción a Verificación Digital (6 h)

Verificación Digital (DV): contexto dentro del flujo de diseño de un chip.

Objetivos. Métodos de verificación. Coverage.

Metodología de trabajo: vPlan, regresiones, bug reporting y bug tracking. Tests dirigidos, tests randomizados, inyección de errores, stress.

Breve introducción a otras disciplinas en DV: verificación formal, emulación, DMS y AMS.

Testeando el test.

SystemVerilog para DV (9 h)

Verilog y SystemVerilog.

Interfaces. Conectando DUT y testbench. Glue logic.

Tipos de datos. Clases y relación entre las clases, patrones de software.

Tareas y funciones.

Randomización y constraints. Estrategias de generación de estímulos.

Hilos y comunicación entre procesos. Eventos, semáforos, mailboxes.

Assertions.

Definición de covergroups y coverpoints. Cross coverage. Sampling.

Breve introducción a DPI.

Ejemplos basados en casos reales.

Introducción a UVM (15 h)

Conceptos básicos de UVM (Universal Verification Methodology). Qué es una librería, un framework y por qué usarlo.

Modularización y reusabilidad.

Tipos de componentes: monitor, driver, agente, environment, scoreboard, testcase.

Arquitectura del testbench. Interacciones entre los componentes: llamadas y agregación. Transacciones, secuencias y uso de puertos.

Representación de registros. RAL.

Prácticas (15 h)

Práctica 1: vPlan.

Verificación de un DUT con SystemVerilog y clases.

Familiarización con las principales herramientas: compilador, simulador, visor de gráficas.

Práctica 2 (*2 sesiones): verificación de un DUT con UVM.

Generación de un testbench con todos los componentes.

Generación de testcases dirigidos.

Práctica 3: randomización y assertions con UVM.

Generación de testcases randomizados. Constraints.Regresiones.

Práctica 4: Coverage.

Creación de covergroups y muestreo.

Análisis de métricas.

Familiarización con las herramientas de recolección de coverage y análisis de métricas.

Consecución de 100% de funcional coverage y code coverage.

Sistemas embebidos

TEORÍA (30h)

Tema 1: Introducción al diseño de sistemas embebidos.

- Tema 2: Arquitectura de los sistemas embebidos.
- Tema 3: Comunicación procesador con lógica programable.
- Tema 4: Creación periféricos usuario.
- Tema 5: Entorno de desarrollo software.
- Tema 6: Desarrollo y depuración software.
- Tema 7: Revisión del diseño de sistemas embebidos en tiempo real.
- Tema 8: Arquitectura avanzada de un sistema embebido.
- Tema 9: Depuración del sistema embebido (HW/SW) utilizando Logic Analyzer.
- Tema 10: Interfaces de memoria en un sistema embebido.
- Tema 11: Manejo de interrupciones en sistemas en tiempo real.
- Tema 12: Estudio de baja latencia y alto ancho de banda.
- Tema 13: Configuración del procesador y creación de un Bootloader del sistema.
- Tema 14: Estudio del profiling y de la optimización de rendimiento de un sistema embebido.

LABORATORIO (30h)

- Laboratorio 1: Diseño hardware de un sistema embebido básico.
- Laboratorio 2: Añadiendo IPs en la lógica programable.
- Laboratorio 3: Creando y añadiendo periféricos propios.
- Laboratorio 4: Escribiendo aplicaciones software básicas.
- Laboratorio 5: Depuración de software utilizando SDK.
- Laboratorio 6: Creación de un sistema embebido completo.
- Laboratorio 7: Depuración software/hardware usando Logic Analyzer.
- Laboratorio 8: Extendiendo el espacio de memoria con BRAM.
- Laboratorio 9: Acceso directo a memoria utilizando CDMA.
- Laboratorio 10: Creación de un Bootloader del sistema embebido.
- Laboratorio 11: Profiling y optimización de rendimiento en sistemas embebidos.

Prácticas en empresa

Los contenidos de la materia serán diferentes dependiendo de la práctica concreta que se deba llevar a cabo. A continuación se relacionan de modo genérico las posibles actividades que pueden realizarse durante las prácticas externas:

- Diseño microelectrónico analógico o mixto
- Diseño microelectrónico digital
- Test y verificación
- Sistemas embebidos. Software y hardware
- Diseño de layout
- Diseño de sistemas electrónicos
- Procesado digital de señal en sistemas VLSI
- ...

Trabajo Fin de Máster

Los contenidos del Trabajo Fin de Master serán diferentes dependiendo de los objetivos concretos del proyecto a realizar. Pueden ser objeto de tema de Trabajo Fin de Master todos aquellos que sean propios de los estudios del Master. En particular, se podrán proyectar toda clase de sistemas y dispositivos microelectrónicos por cuantos procedimientos permita realizar la ingeniería actual. También podrá ser objeto del Trabajo Fin de Master los trabajos de investigación y desarrollo, y el modelado teórico o numérico de los dispositivos, circuitos o sistemas microelectrónicos. Se podrán considerar asimismo como temas de Trabajo Fin de Master los estudios relacionados con los contenidos de la Titulación y relativos a equipos, fábricas, instalaciones, servicios o su planificación, gestión o explotación. Por tanto los contenidos de la materia serán diferentes dependiendo del trabajo fin de máster concreto que se haya seleccionado por el alumno.

Seminarios

Aunque la lista de seminarios será dinámica, se proponen, en esta primera edición, los siguientes títulos:

- Fully Integrated Frequency Synthesizers: PLLs for Modern Wireless Communications Systems
- WiFi7 Physical layer transceiver design. An overview
- Clock Distribution for Modern RF ICs: an overview
- SW/HW codesign: FW architectures and development process during System On Chip design
- Digital verification: practical use case
- Business aspects in IC design
- Verification
- Medical applications
- Industrial applications
- Measurements

Diseño microelectrónico analógico avanzado (A1)

TEORIA (12h)

1. Revisión de estructuras básicas de circuitos
2. Técnicas de control aplicadas en diseño microelectrónico analógico
3. Ruido
4. Técnicas de layout
5. Ejemplos prácticos de proyectos: referencias de voltaje
6. Ejemplos prácticos de proyectos: reguladores de voltaje

LABORATORIO (18h)

1. Proyecto práctico I: Diseño y layout de una referencia de voltaje (parte 1/3)

2. Proyecto practico I: Dise±o y layout de una referencia de voltaje (parte 2/3)
3. Proyecto practico I: Dise±o y layout de una referencia de voltaje (parte 3/3)
4. Proyecto practico II: Dise±o y layout de un regulador de voltaje (parte 1/3)
5. Proyecto practico II: Dise±o y layout de un regulador de voltaje (parte 2/3)
6. Proyecto practico II: Dise±o y layout de un regulador de voltaje (parte 3/3)

Dise±o de componentes de radiofrecuencia y microondas integrados (A2)

TEORIA (20h)

1. Introduction a sistemas de comunicaci³n.
2. Componentes para desarrollo de bloques de radio frecuencia.
 - Extensi³n modelos RF
 - Mecanismos de degradaci³n y reliability
 - L³neas de transmisi³n integradas
 - encapsulado
 - Bobinas integradas y extensi³n de RF de componentes pasivos
3. Dise±o amplificadores RF.
 - Introducci³n par³metros S
 - Criterios estabilidad
 - Topolog³as y amplificadores ganancia programable.
- 4.. Amplificadores de bajo ruido
 - topolog³as
 - t³cnicas cancelaci³n ruido
5. Amplificadores de Potencia
 - topolog³as
 - mecanismos de degradaci³n, SOA y electro migraci³n
6. Mezcladores:
 - activos vs pasivos
 - t³cnicas mejora linealidad
7. Osciladores
 - osciladores de anillo.
 - osciladores LC.
 - Osciladores Colpits.
 - Osciladores controlados digitalmente.

LABORATORIO (10h)

- P1. Dise±o y simulaci³n L³neas de transmisi³n en inductancias
- P3. Selecci³n punto de polarizaci³n de un transistor y Layout
- P4. Dise±o Amplificador bajo ruido
- P5. Dise±o y simulaci³n de un Mezclador.
- P5. Dise±o y Simulaci³n de un VCO

Dise±o de sistemas microelectr³nicos (A3)

TEORIA

- Tema 1: Circuitos de capacidades conmutadas (4h)
- Tema 2: T³cnicas de compensaci³n de offset, ruido de baja frecuencia y desapareamiento (4h)
- Tema 3: Convertidores de Nyquist (4h)
- Tema 4: Convertidores de sobremuestreo (4h)
- Tema 5: Sensores de temperatura integrados. (4h)
- Tema 6: Frontends para sensores capacitivos, resistivos o inductivos (4h)

LABORATORIO

- Pr³ctica 1: t³cnicas de simulaci³n de circuitos en tiempo discreto (1.5h)
- Pr³ctica 2: modelado de comportamiento de moduladores sigma-delta (1.5h)
- Pr³ctica 3: dise±o y simulaci³n de circuitos SC para convertidores Sigma-Delta (1.5h)
- Pr³ctica 4: dise±o y simulaci³n de un sensor de temperatura (1.5h)

Dise±o microelectr³nico digital avanzado (D1)

TEORIA (15h)

- Dise±o Digital con System Verilog (8h)
- Codificaci³n de dise±os para s³ntesis. (2h)
- Codificaci³n de M³quinas de Estado Finitas. (1h)
- Generaci³n, procesado y distribuci³n de relojes y resets (1.5h)
- Sincronizaci³n de datos entre dominios de reloj y dominios de reset (1.5h)
- Dise±o de Bajo Consumo con UPF. Clock Gating, Power Gating, DVFS. (2h)
- Implementaci³n Digital VLSI (7h)
- Introducci³n al Flujo de Implementaci³n Digital (0.5h)
- Biblioteca de Celdas Digitales en Procesos de Fabricaci³n Avanzados (0.5)
- Definici³n de Restricciones Temporales (1h)
- S³ntesis (1h)
- Dise±o para Test (1h)
- Emplazamiento y Rutado (1h)
- An³lisis Temporal Est³tico (1h)
- An³lisis de Consumo (1h)

LABORATORIO (15h)

Proyecto practico 1: Dise±o RTL (Verilog) (7h)
Codificaci3n de dise±os para sAntesis
Codificaci3n de Mquinas de Estado Finitas
Generaci3n, procesado y distribuci3n de relojes y resets
Sincronizaci3n de datos entre dominios de reloj y dominios de reset
Proyecto practico 2: implementaci3n (6h)
SAntesis
Dise±o para Test
Emplazamiento y Rutado
Proyecto practico 3: anlisis (2h)
Anlisis Temporal Esttico
Anlisis de Consumo

Procesado digital de se±al en dise±os VLSI (D2)

TEORIA (18h)

Tema 1: Introducci3n a funciones principales de un sistema de comunicaciones
Tema 2: Adquisici3n de datos
Tema 3: Cuantificaci3n
Tema 4: Filtros, interpoladores/diezmadores
Tema 5: Modulaci3n/Demodulaci3n
Tema 6: Optimizaci3n de Velocidad, rea y Consumo

LABORATORIO (12h)

Laboratorio 1: Arquitectura de un filtro FIR
Laboratorio 2: Implementaci3n de un filtro FIR
Laboratorio 3: Simulaci3n de un filtro FIR

Sistemas digitales integrados. MCU embebidos (D3)

TEORA (18h)

Tema 1: Introducci3n (2h)
- Diferencias entre uC/Cpu/Core
- Principales fabricantes de CPU del mercado
- Profundizar en la introducci3n del ARM M4-Cortex como Core de Referencia para el curso
Tema 2: Cortex-M4 core (4h)
- Caractersticas del core
- Modelo de memoria
- Registros de proposito general
- Stacks
- Niveles de acceso y modos de programaci3n
- Excepciones
- Vector table
- Fault handling
- Instrumentation Trace Macrocell (ITM)
- AHB Access Port (AHB-AP)
- Bus Matrix
Tema 3: Perifericos del ARM M4-Cortex (4h)
- Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC)
- System Control Block
- System timer
- Memory Protection Unit (MPU)
- Floating-point unit
Tema 4: Herramientas para programar un ARM M4-Cortex (3h)
- Proceso de compilacion
- Toolchain
- Makefile
- Startup file
- Linker script
Tema 5: Integraci3n de una CPU en diferentes microcontroladores (2h)
- ARM M4 por stm32f4 y texas
- ARM M0 por raspberry pico y stm32m0
- Otros ejemplos...
Tema 6: Interaccion del ARM M4-Cortex con los masters y esclavos del Stm32F4 (3h)
- Arquitectura del sistem de un Stm32F4
- Organizacion de la memoria
- Mapa de memoria

LABORATORIO (12h)

LAB1: Interacci3n con los registros de proposito general y de las configuraciones basicas
LAB2: Cambios de contexto para Irq y Excepciones Vs Interacci3n funciones caller/callee
LAB3: Creaci3n de un Scheduler
LAB4: Creaci3n Startup file + linker script
LAB5: Migrar todo lo realizado hasta ahora a la toolchain creando un makefile

Tema 1: Introducción a los sistemas embebidos (1h)

- Conceptos básicos de los sistemas embebidos. Características diferenciales
- Tipos de sistemas embebidos
- Aplicaciones de los sistemas embebidos
- Seguridad de los sistemas embebidos

Tema 2: Lenguajes de programación para sistemas embebidos (1h)

- Lenguajes de bajo nivel para sistemas embebidos. Ensamblador
- Lenguajes de alto nivel para sistemas embebidos. C y herramientas de compilación.
- Lenguajes de scripting Átiles
- Interfaz entre diferentes lenguajes de programación

Tema 3: Arquitecturas SW/HW para sistemas embebidos (1h)

- CPUs
- Memorias
- Hosted/Hostless
- Flash/Flashless
- SDK y API de clientes
- VKs

Tema 4: Desarrollo de software para sistemas embebidos (1h)

- Ciclo de vida del desarrollo de software para sistemas embebidos
- Metodologías ágiles de desarrollo de software para sistemas embebidos
- Herramientas de desarrollo de software para sistemas embebidos

Tema 5: Descripción de características deseables del flujo de desarrollo (2h)

- Reducción del Time-to-market
- Definición de requisitos
- Funcionales
- Temporales
- Coste
- Etc.
- Arquitectura de Sistema
- Co-diseño HW/SW
- Plataformas de pruebas HW/SW
- Simulaciones
- Emuladores
- FPGAs
- Definición de interfaces HW/SW
- HW drivers
- Proceso de bringup
- Test Driven Development (TDD)
- Control de versiones (SCM)
- Gestión de tareas y errores en proyectos (Agile + Jira)
- Tests de Sistema
- Sistemas de Integración Continua
- Test benches
- Documentación

Tema 6: Diseño de software para sistemas embebidos (3h)

- SW product line: HW and SW configurations
- Arquitectura SW de capas, componentes e interfaces
- Diseño para el re-uso
- Capas de abstracción, HAL, OSAL.
- Código independiente de aplicación
- Código dependiente de aplicación
- Componentes de terceros y cuestiones legales
- Diseño para compatibilidad hacia atrás
- Diseño escalable
- Uso extensivo de técnicas de programación defensiva (assert)
- Chequeo de hard/soft deadlines
- Chequeo de problemas con la memoria (overwrites, stack overflows, etc)- Sistemas operativos de tiempo real (RTOS)
- Configuración
- Threads y prioridades
- Interrupciones
- Timers
- Stacks
- Primitivas de comunicación
- Aplicaciones multiprocesador
- Utilidades de debug y análisis del rendimiento
- Problemas recurrentes:
- Thread preemption
- Tiempo de respuesta a interrupciones
- Inversión de prioridades
- Tipos de Componentes
- HOST SW: drivers, apps, libs

- Firmware: dev, prod, BIST, loader
- Herramientas y scripts
- Interface p blicos / privados

Tema 7: Funcionalidades usuales en sistemas embebidos (2h)

- Configuraci3n especfica del producto
- Producci3n
- Remota
- SW upgrades
- SDK para extender/cambiar funcionalidad
- Flash FS
- Interfaces
- JTAG
- UART
- SPI
- Consola de debug/operacion
- Watchdog
- Herramientas de debug
- Memoria din mica

Tema 8: Optimizaci3n de SW en Sistemas Embebidos (2h)

- Memoria vs Rendimiento
- Coste vs Facilidad en el desarrollo
- Requisitos HW
- Optimizaci3n de Memoria
- Compactaci3n de estructuras de datos
- Datos en memorias compartidas
- Asignaci3n de memoria (linker script)
- Reutilizaci3n de memoria
- Implementaci3n de subsets de librer as (matem ticas, libc )
- Optimizaci3n de rendimiento
- Aritm tica de punto fijo
- Uso de ensamblador.
- Re-escritura de c digo para uso de HW espec fico (DSP)
- DMA

Tema 9: An lisis de fallos en Sistemas Embebidos (2h)

- Requisitos HW
- JTAG
- Unit Tests
- Logs (serial, ethernet, files ).
- Debug Buffers
- CPU Trace buffer
- Memory dumps
- An lisis de problemas en tiempo. Profiling
- Parseo y visualizaci3n de datos.
- Debug en sistemas multiprocesador

LABORATORIO:

La duraci3n de cada laboratorio ser  de 1,5h:

Laboratorio 1: Dise o de la arquitectura de un sistema embebido

- Requisitos
 - Arquitectura y codise o HW/SW
 - Ventajas y desventajas de las distintas opciones en cuanto a coste, facilidad de desarrollo, rendimiento, etc.
- Laboratorio 2: M quina virtualizada para desarrollo
- Virtualizaci3n de la plataforma de dise o (Docker)
 - Herramientas de desarrollo (GNU)
 - Sistema de control de versiones (GIT)
 - Unit tests (Google Test)
 - An lisis Est tico de C digo (CppCheck)
 - Cobertura de testeo (Gcov)
 - An lisis din mico de C digo (Valgrind/Electric Fence)

Laboratorio 3: Implementaci3n de plataforma SW independiente de la aplicaci3n sobre un simulador de RTOS

Laboratorio 4: Implementaci3n de utilidades para debug (I)

Laboratorio 5: Implementaci3n de utilidades para debug (II)

Laboratorio 6: Implementaci3n de Mock para simular un HW especifico

Laboratorio 7: Implementaci3n de una aplicaci3n real time ejemplo sobre la plataforma anterior (I)

Laboratorio 8: Implementaci3n de una aplicaci3n real time ejemplo sobre la plataforma anterior (II)

Laboratorio 9: Debug funcional de la aplicaci3n

Laboratorio 10: An lisis de rendimiento y uso de memoria

Control de calidad (QA) en sistemas embebidos (S2)

TEORIA (15h)

Tema 0: Conceptos de validación y aseguramiento de la calidad (QA)

- Modelo en V
- Requisitos
- Pruebas
- Depuración y defectos
- Conceptos de CI y de CD (Continuous Integration & Continuous Delivery)

Tema 1: Definición de requisitos

- Requisitos hardware
- Requisitos software
- Requisitos de sistema
- Herramientas de gestión de requisitos

Tema 2: Definición de prueba a partir de requisitos

- Herramientas existentes vs propias
- Tipos de pruebas (caja negra, caja blanca, funcionales, no funcionales...)
- Definición de indicadores clave de rendimiento (KPI) a partir de requisitos
- Definición de criterios de aceptación ¿pass/fail?

Tema 3: Introducción a la validación de sistemas embebidos

- Validación de sistemas embebidos vs sistemas software:
- Disponibilidad de recursos
- Tiempos de ejecución

- Posibilidad de automatización
- Definición de sistema bajo prueba
- Interacción con el sistema bajo prueba

Tema 4: Ejecución y automatización de pruebas

- Definición de bancos de prueba
- Pruebas automáticas vs manuales: Por qué automatizar
- Automatización:
- Codificación: Control de cambios
- Instrumentación
- Ejecución
- Informes
- Herramientas:
- Lenguajes de programación para pruebas automáticas
- Herramientas para registrar progreso de pruebas
- Frameworks de prueba
- Recolección organizada de datos para informe de defectos

Tema 5: Defectos

- Qué es un defecto y cómo identificarlos
- Cómo reportar un defecto correctamente
- Herramientas de informe y trazabilidad de defectos

Tema 6: CI para productos embebidos

- Qué ofrece una herramienta de CI en la validación de productos embebidos:
- Definición de trabajos fácilmente repetibles
- Distribución de los trabajos entre hardware disponible
- Ventajas de tener un CI automatizado:
- Optimización de tiempo máquina
- Distribución de recursos
- Informes de resultados automáticos
- Gestión de bancos de prueba:
- Coexistencia entre automatización y uso manual de recursos
- Interacción de los componentes de un entorno de CI- Herramientas habituales de CI:
- Jenkins, Teamcity, Jira Workflow

Tema 7: Obtención y análisis de indicadores clave de rendimiento (KPI)

- KPI relacionados con el producto:
- Rendimiento
- Estabilidad
- Repetibilidad
- KPI relacionados con el entorno de CI:
- Cobertura de requisitos
- Tiempo entre detección de defecto y el arreglo
- Uso de recursos

LABORATORIO (15h)

Laboratorio 1: Definir requisitos a partir de una descripción breve de un producto.

Laboratorio 2: Definición de pruebas a partir de requisitos. Plan de prueba.

Laboratorio 3: Ejecución manual de un plan de prueba. Pruebas exploratorias.

Laboratorio 4: Automatización de las pruebas definidas.

Laboratorio 5: Identificación y reporte de defectos a partir de los resultados de las pruebas.

Laboratorio 6: Creación de un entorno CI completo.

Laboratorio 7: Definición de KPI a partir de requisitos y resultados de las pruebas.

Sistemas operativos en tiempo real (S3)

TEORIA (10h)

Conceptos generales de arquitectura de computadores

- La arquitectura (ISA: Instruction Set Architecture)

Diferencias entre CISC y RISC

- La CPU (Unidad Central de Proceso)

Unidad de control

ALU (Unidad Aritmética-Lógica)

Buses

Cache de instrucciones

Pipelining

Registros

- Cores

- Memoria (ROM, RAM)

Memoria caché

- Periféricos de entrada/salida

Interrupciones

- Microcontroladores

Conceptos generales de software

- Lenguajes de programación

Relación entre juego de instrucciones, código objeto y lenguaje ensamblador

- Tipos de archivo ejecutable

- Compiladores

- El linker o enlazador

Linker scripts y scatter files

- Memoria estática y dinámica

El stack y el heap

- El cargador de arranque o bootloader

Tiempo real y conceptos de RTOS

- RTOS vs GPOS

Latency

- RTOS vs μ bare-metal (μ super loop)

- Kernel / Scheduler

preemptive time-slicing

cooperative time-slicing

Tick, Idle task, Tickless idle

- Interrupciones hardware y software

- Tareas e hilos

thread stack

prioridades

o Paralelismo y concurrencia

Sección Crítica

Semáforos, mutex y operaciones atómicas

Colas de mensajes o otros mecanismos

Condition variables

Problemas clásicos

productor/consumidor

condición de carrera

inversión de prioridades

- Procesadores multi-core

SMP (Symetric Multi-Processing)

AMP (Asymmetric Multi-Processing)

- Comunicación entre tareas

Análisis de los RTOS más comúnmente usados

- FreeRTOS

- MicroC/OS-II (uCOS)

- ThreadX

- RTEMS

- Zephyr

- VxWorks

RTOS en FPGAs

- Procesadores softcore. Ejemplos

Xilinx Microblaze

Tensilica Xtensa

Implementaciones RISC-V (Mi-V RV32, NEORV32, FEMTORV32)

LABORATORIO (20h)

Proyecto de un pequeño sistema controlado por RTOS:

Control de un ventilador accionado por motor DC (PWM) de forma automática mediante sensor de temperatura y controlable mediante comandos por Ethernet.

[Proyecto industrial en microelectrónica](#)

Los contenidos del "Proyecto Industrial en Microelectrónica" serán diferentes dependiendo de los objetivos concretos del

proyecto a realizar. Pueden ser objeto de tema de aquellos que sean propios de los estudios del título. En particular, se podrán proyectar toda clase de sistemas y dispositivos microelectrónicos por cuantos procedimientos permita realizar la ingeniería actual. También podrán ser objeto del Proyecto Industrial en Microelectrónica los trabajos de investigación y desarrollo, y el modelado teórico o numérico de los dispositivos, circuitos o sistemas microelectrónicos. Se podrán considerar asimismo los estudios relacionados con los contenidos del título relativos a equipos, fábricas, instalaciones, servicios o su planificación, gestión o explotación.

PROFESORADO

Alejandro Acuña Muñoz

Ingeniero de Diseño Analógico. Maxlinear

Andrés Almarcha López

Senior Staff Digital IC Design Verification Technical Lead

María Teresa Bacete Castellá

Site Director. Maxlinear

José Antonio Boluda Grau

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Informàtica. Universitat de València

Javier Calpe Maravilla

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Miguel Chanca Martín

IC Lead. Robert Bosch

Fausto Codina Ferrás

Senior Manager Layout. Analog Devices

Enrique Company Bosch

Analog Design Manager. Analog Devices

Pablo Cruz Dato

Digital Architect. Bosch.

Francisco Escuder Roberto

Responsable de software. MaxLinear Hispania, S.L.

Luis Alfonso Espinosa Ortega

Ingeniero de Firmware. Analog Devices, S.L.U

José Manuel García González

Senior Principal design engineer. Ams-OSRAM

José Luis García Navas

Ingeniero de calidad de software. MaxLinear Hispania, S.L.

Raimundo García Olcina

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Marcos Hervás García

Ingeniero de Diseño Digital. MaxLinear Hispania, S.L.

Francisco Javier Jiménez Marquina

Director de Ingeniería. MaxLinear

Jose Rafael Lajara Vizcaino

Profesor/a Asociado de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Enrique Llorens Bufort

Ingeniero de Diseño Digital. MaxLinear Hispania, S.L.

José Marqués Hueso

Investigador/a distinguido/a Beatriz Galindo. Universitat de València

José Francisco Martín Martín

Software/Firmware Design Engineer. Ams-OSRAM

Fernando Pardo Carpio

Catedrático/a de Universidad. Departament d'Informàtica. Universitat de València

Joaquin Perez Soler

Ayudante/a Doctor/a. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Sebastien Poirier

Principal engineer. Ams OSRAM

Ricardo Purity Coimbra

Principal Analog Design Engineer. Analog Devices

Abilio Candido Reig Escriva

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Samuel Rodríguez Rodríguez

Ingeniero de Verificación

Antonio Jesús Rubio Salcedo

Ingeniero de Verificación de Diseño. Analog Devices, S.L.U

Rubén Salvador Edo

Diseñador Digital de Circuitos. Analog Devices, S.L.U

Rafael Serrano-Gotarredona

Director General. ams-OSRAM

Jesús Soret Medel

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Issac Suarez Alvarez

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Riccardo Tonietto

Analog IC Designer. Bosch

José Gabriel Torres Paás

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Ramón Tortosa Navas

Principal Engineer. Analog Devices, S.L.U

Lucas Valentin García

Algorithms and Machine Learning Engineer. Analog Devices, S.L.U

OBJETIVOS

Las salidas profesionales que tiene el curso son:

Las salidas profesionales previstas están estrechamente vinculadas a los perfiles más demandados en este ámbito, entre los que se podrán destacar:

Diseñadores de sistema (arquitectura del chip, partición Hw/Sw, algorítmica, DSP...); desarrolladores de flujo de diseño digital; diseñadores de procesadores y memorias embebidas; diseñadores analógicos; diseñadores RF y MMIC; ingenieros de diseño físico (P&R); diseñadores de dispositivos (layout); ingenieros de estándares; ingenieros de firmware; ingenieros de software; ingenieros de test; ingenieros de calidad y fiabilidad; ingenieros de packaging (chiplet...); diseñadores de sensores y MEMS; tecnólogos; diseñadores de dispositivos optoelectrónicos; diseñadores de PCBs; ...

En los últimos tiempos, las empresas del sector de la microelectrónica y los semiconductores han visto como sus ofertas de trabajo quedaban frecuentemente vacantes por falta de personas con la formación demandada para puestos tan específicos. Por tanto, el objetivo fundamental de este Máster es ofrecer al ecosistema VaSiC perfiles profesionales con las competencias necesarias para ser directamente incorporados en sus plantillas.

METODOLOGÍA

El centro responsable del Máster de Formación Permanente Multinacional en Microelectrónica es la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), y se impartirá de forma presencial, en castellano, en horario de tardes y sábado. La matrícula será gratuita. Este Máster propio se desarrolla en 60 ECTS, entre los que se incluyen 6 de prácticas en empresa y 9 de TFM, todos ellos a desarrollar en proyectos en empresas de VaSiC. La primera mitad del máster consistirá en cinco asignaturas fundamentales, de

6 ECTS cada una, donde se presentarán contenidos de Dispositivos electrónicos y fotónicos, Diseño CMOS analógico, Diseño CMOS digital, Test y verificación y Sistemas embebidos. Estos contenidos serán impartidos principalmente por profesorado de la ETSE. En la segunda parte, junto con las PdE y el TFM, el alumnado podrá elegir entre tres itinerarios: Diseño microelectrónico avanzado analógico y mixto, Diseño digital avanzado y Sistemas-en-Chip (SoC). Para ello, se podrán elegir cinco asignaturas optativas de 3 ECTS cada una entre nueve posibles, y una de Seminarios. Estas asignaturas serán impartidas en su práctica totalidad por profesorado especialista de las empresas de VaSiC. Todas las asignaturas, tanto las fundamentales como las optativas, incluirán contenidos teóricos y contenidos prácticos. El alumnado dispondrá de ordenadores adecuados con las herramientas utilizadas en el estándar industrial para el desarrollo y análisis de los sistemas que se propongan: Cadence, Synopsys, desarrollo ARM, Matlab... También dispondrán del instrumental necesario para el test y caracterización de los dispositivos que se estudien. Se prevén prácticas en sala blanca.